

股票简称:乐鑫科技

股票代码:688018

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐人(主承销商)



(深圳市福田区福华一路111号)

2019年7月19日

特别提示

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市,本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

1、涨跌幅限制
科创板股票价格交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为30%,较主板新股上市首日涨跌幅限制44%,次交首日开始涨跌幅限制为10%,科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

2、流通股数量较少
本次公开发行2,000万股,发行后总股本8,000万股。其中,无限售流通股1,743.7114万股,占本次公开发行股票总量的87.19%,占发行后总股本的比例为21.80%,提请投资者注意流通股数量较少的风险。

3、市盈率高于同行业平均水平
公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2019年7月5日(即3日),中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.11倍。本公司本次发行市盈率为56.67倍。每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

4、融资资金需求
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险,保证金追加风险和流动性风险。

二、特别风险提示
(一)市场竞争加剧的风险

公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(三)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(四)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(五)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(六)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(七)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(八)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(九)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十一)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十二)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十三)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十四)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十五)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十六)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十七)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十八)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(十九)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十一)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十二)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十三)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十四)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十五)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十六)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十七)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十八)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(二十九)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(三十)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(三十一)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(三十二)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

(三十三)市场竞争加剧的风险
公司主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研究、设计及销售,面向的下游市场包括智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等领域。近年来,物联网市场发展迅速,方兴未艾,随着市场需求快速增长,业内竞争者对于进一步加大投入或新进入行业的竞争企业增加,将使公司面临市场竞争加剧的风险。

股,承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。

参与网下发行申购乐鑫科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的管理的社会保障基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为151个,所持股份数量为922,311股,占发行后总股本的1.15%。

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(十四)上市保荐机构:招商证券股份有限公司

三、公司选定的上市标准
(一)市值标准
根据本次发行价格62.60元,及发行后总股本8,000万股测算,公司发行后市值50.08亿元,不低于10亿元。

根据查阅和分忻天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的13JS5号《审计报告》,发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以下简称“科创板股票上市规则”)第2.1.2条第一项规定的财务指标,具体情况分析如下:

财务指标要求	项目	金额(万元)	是否满足科创板股票上市规则)第2.1.2条第一项规定的财务指标
最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元	2017年度的净利润	2,937.19	是
	2018年度的净利润	8,836.40	是
	2017年度和2018年度累计净利润	11,773.59	是

最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元	2018年度的净利润	8,836.40	是
	2018年度营业收入	47,492.02	是

(注:净利润扣除非经常性损益前后的孰低者为准)

发行人结合自身状况,公司满足《科创板股票上市规则》第2.1.2条第一项规定:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元)中规定的市值及财务指标。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1.公司名称:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
- 2.英文名称:Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
- 3.注册资本:6,000万元(体次发行后)3,800万元(体次发行后)
- 4.法定代表人:Teo Swee Ann
- 5.成立日期:2008年4月29日,于2018年11月26日整体变更为股份有限公司
- 6.住所:中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室

7.经营范围:计算机软硬件的研究、开发、计算机软硬件的研发、开发、设计、制作、销售;电子产品;集成电路;通信产品;及其零配件的研发、设计、上述同类产品、灯具的批发、进出口、佣金代理(含税除外),并提供相关的技术咨询和技术服务(不涉及国家贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

8.主营业务:公司是一家专业的集成电路设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能能源、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

9.所属行业:根据《上市公司行业分类指引》2012修订)分类,本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

10.邮政编码:201203
11.电话号码:021-61065218
12.传真号码:021-61065218
13.互联网网址:<http://www.espressif.com>
14.电子信箱:ir@espressif.com

15.董事会秘书:王珏
二、公司控股股东及实际控制人的情况
(一)控股股东
乐鑫香港直接持有本公司本次发行前58.10%的股份,为公司控股股东,注册地址及主要经营地为Units 3306-12, 33F, Shui On Centre, Nos. 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong。截至本上市公告书签署日,乐鑫香港股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数量
1	ESP Investment	1.00%	100,000股
2	合计	1.00%	100,000股

(二)实际控制人

Teo Swee Ann通过Impromptu, ESP Tech, ESP Investment及乐鑫香港的架构间接持有本公司本次发行前58.10%的股份,为公司实际控制人。
Teo Swee Ann先生,1975年9月出生,新加坡籍,本科及硕士均毕业于新加坡国立大学电子工程专业。主要经历如下:2000年3月至2001年4月任Transilica Singapore Pte Ltd设计工程师;2001年5月至2004年5月任Marvell Semiconductor Inc.高级设计工程师;2004年5月至2007年6月任浪潮科技(上海)有限公司技术总监;2008年4月至2011年11月任乐鑫香港首席执行官;2010年3月至今任其鑫瑞执行董事兼总经理;2011年1月至今任ESP Inc.董事;2014年9月至今任Impromptu董事;2014年9月至今任ESP Tech董事;2014年10月至今任ESP Investment董事;2014年11月至今任乐鑫科技董事;2016年4月至今任乐鑫星执行董事兼总经理;2016年8月至今任乐鑫加执行董事;2017年6月至今任乐鑫捷执行董事;2017年7月至今任合肥乐和执行董事兼总经理;2018年1月至今任乐鑫捷执行董事;2018年11月至今任本公司董事长、总经理。

(三)本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后,乐鑫香港直接持有本公司43.575%的股份,为公司控股股东;Teo Swee Ann通过Impromptu, ESP Tech, ESP Investment及乐鑫香港的架构间接持有本公司43.575%的股份,为公司实际控制人。

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事基本情况
截至本上市公告书签署日,本公司董事会成员共7名,其中3名为独立董事。公司现任董事情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	TEO SWEE ANN	董事长、总经理	2018年11月至2021年11月
2	NG PEI CHI	董事	2018年11月至2021年11月
3	TEO TECK LEONG	董事	2018年11月至2021年11月
4	徐敏	董事	2018年11月至2021年11月
5	蓝子晔	独立董事	2018年11月至2021年11月
6	KOH CHUAN KOON	独立董事	2018年11月至2021年11月
7	LEE SZE CHIN	独立董事	2018年11月至2021年11月

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司监事会由三名监事组成,公司现任监事情况如下:

序号	姓名	职务	本届任期
1	蔡敏婕	监事会主席、职工代表监事	2018年11月至2021年11月
2	姜江建	监事	2018年11月至2021年11月
3	符运生	监事	2018年11月至2021年11月

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日,本公司共有高级管理人员3名,现任高级管理人员情况如下:

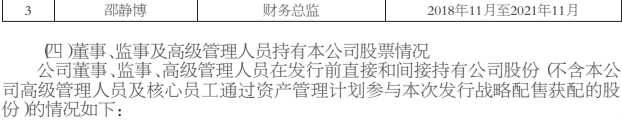
序号	姓名	职务	本届任期
1	TEO SWEE ANN	董事长、总经理	2018年11月至2021年11月
2	王珏	副总经理、董事会秘书	2018年11月至2021年11月
3	邵静博	财务总监	2018年11月至2021年11月

四、董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况
公司董事、监事、高级管理人员在发行前直接和间接持有公司股份(不含本公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)的情况如下:

序号	姓名	现任职务	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持股比例(发行后)	间接持股平台	限售期
1	Teo Swee Ann	董事长、总经理、核心技术人员	—	3,486.00	43.58%	乐鑫香港	自上市之日起锁36个月
2	Teo Teck Leong	董事	—	46.59	0.58%	Shinvest	自上市之日起锁12个月
3	姜江建	董事、核心技术人员(研发部软件组通讯软件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
4	符运生	董事、核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
5	王珏	副总经理、董事会秘书	—	0.96	0.01%	乐融投资	自上市之日起锁12个月

上述公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书第八节“重要承诺事项”的相关内容。

五、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



六、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

序号	姓名	现任职务	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持股比例(发行后)	间接持股平台	限售期
1	Teo Swee Ann	董事长、总经理、核心技术人员	—	3,486.00	43.58%	乐鑫香港	自上市之日起锁36个月
2	Teo Teck Leong	董事	—	46.59	0.58%	Shinvest	自上市之日起锁12个月
3	姜江建	董事、核心技术人员(研发部软件组通讯软件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
4	符运生	董事、核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
5	王珏	副总经理、董事会秘书	—	0.96	0.01%	乐融投资	自上市之日起锁12个月

上述公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的限售安排详见本上市公告书第八节“重要承诺事项”的相关内容。

七、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

序号	姓名	现任职务	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持股比例(发行后)	间接持股平台	限售期
1	Teo Swee Ann	董事长、总经理、核心技术人员	—	3,486.00	43.58%	乐鑫香港	自上市之日起锁36个月
2	姜江建	董事、核心技术人员(研发部软件组通讯软件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
3	符运生	董事、核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
4	王珏	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	18.42	0.23%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
5	姜江建	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	14.38	0.18%	乐融投资	自上市之日起锁12个月

八、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

序号	姓名	现任职务	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持股比例(发行后)	间接持股平台	限售期
1	Teo Swee Ann	董事长、总经理、核心技术人员	—	3,486.00	43.58%	乐鑫香港	自上市之日起锁36个月
2	姜江建	董事、核心技术人员(研发部软件组通讯软件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
3	符运生	董事、核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
4	王珏	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	18.42	0.23%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
5	姜江建	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	14.38	0.18%	乐融投资	自上市之日起锁12个月

九、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

序号	姓名	现任职务	直接持股(万股)	间接持股(万股)	持股比例(发行后)	间接持股平台	限售期
1	Teo Swee Ann	董事长、总经理、核心技术人员	—	3,486.00	43.58%	乐鑫香港	自上市之日起锁36个月
2	姜江建	董事、核心技术人员(研发部软件组通讯软件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
3	符运生	董事、核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
4	王珏	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	18.42	0.23%	乐融投资	自上市之日起锁12个月
5	姜江建	核心技术人员(研发部数字系统开发总监)	—	14.38	0.18%	乐融投资	自上市之日起锁12个月

十、本次发行后,发行人及控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

2	姜江建	研发部软件组通讯 固件开发总监)	—	23.82	0.30%	乐融投资	自上市之日起锁 定12个月
3	符逸生	监事、核心技术人员 (研发部数字系统开 发总监)	—	22.86	0.29%	乐融投资	自上市之日起锁 定12个月
4	王强	核心技术人员 研发 部模拟系统开发总	—	18.42	0.23%	乐融投资	自上市之日起锁 定12个月